

1/7/2

DIALOG(R)File 347.JAPIO

(c) 2006 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06342629 **Image available**

FLAT MOUNTING TYPE LED ELEMENT

PUB. NO.: 11-284233 [JP 11284233 A]

PUBLISHED: October 15, 1999 (19991015)

INVENTOR(s): WATANABE HARUYUKI

NOMURA TADASHI

APPLICANT(s): STANLEY ELECTRIC CO LTD

APPL. NO.: 10-082206 [JP 9882206]

FILED: March 27, 1998 (19980327)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the temperature rise of a flat mounting type LED element by improving the luminous flux utilization factor of the element.

SOLUTION: Since the horn section 3 of a flat mounting type LED element 1 is formed of a reflecting surface 3a constituted of a tapered through hole 2a having an expanded top and a bottom face 3b constituted of copper foil 4 stuck top the lower surface of a resin substrate 2, the luminous flux utilization factor of the LED element is improved by changing the direction of light toward the lateral direction from the LED chip 6 to a lighting direction Z by means of the reflecting surface 3a of the tapered horn section 3 having the expanded top. Since the bottom face 3b of the horn section 3 is constituted of the copper foil 4, in addition, the cooling efficiency of the LED element is improved and the temperature rise of the element is suppressed.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

1/67/2

DIALOG(R)File 350:Derwent WPIX

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0009720607 - Drawing available

WPI ACC NO: 2000-005310/

Flat surface mounted LED element for opto-electronic application - has tapering through-hole in resin board in which horn part is provided, with copper laminate stuck to base of resin board

Patent Assignee: STANLEY ELECTRIC CO LTD (SNLE)

Inventor: NOMURA T; WATANABE H

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent Application

Number	Kind	Date	Number	Kind	Date	Update
JP 11284233	A	19991015	JP 199882206	A	19980327	200001 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 199882206 A 19980327

Patent Details

Number	Kind	Lan	Pg	Dwg	Filing	Notes
JP 11284233	A	JA	4	2		

Alerting Abstract JP A

NOVELTY - A reflecting surface (3a) of resin board (2) has a tapering through-hole (2a) in which a horn part (3) is provided. The resin board has copper laminate (4) stuck to base (3b).

USE - For opto-electronic applications.

ADVANTAGE - Since through-hole housing horn part is made tapering in shape in direction of radiation, beam utilization factor is raised. Since copper laminate is stuck to backside of resin board, cooling efficiency of LED chip is raised. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows sectional view of flat type LED element. (2) Resin board; (2a) Through-hole; (3) Horn part; (3a) Reflecting surface; (3b) Base; (4) Copper laminate.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-284233

(43) 公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.⁸

H 0 1 L 33/00

識別記号

F I

H 0 1 L 33/00

N

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平10-82206

(22) 出願日 平成10年(1998)3月27日

(71) 出願人 000002303

スタンレー電気株式会社

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

(72) 発明者 渡辺 晴志

神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-51-17

(72) 発明者 野村 直史

神奈川県横浜市都筑区東方町1149

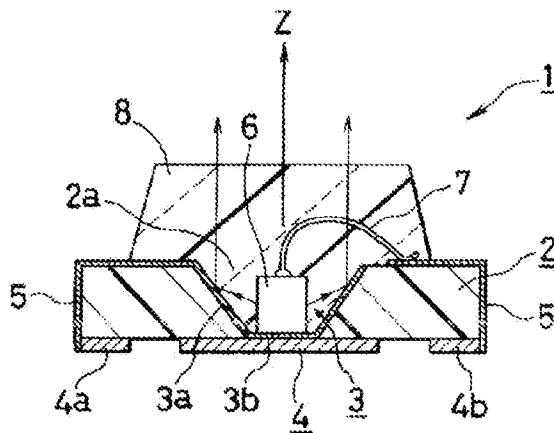
(74) 代理人 弁理士 秋元 輝雄

(54) 【発明の名称】 平面実装型LED素子

(57) 【要約】

【課題】 従来のこの種の平面実装型LED素子においては、反射面が照射方向に対し平行であるのでLEDチップに対しての光束利用率が低く、点灯電流の割には暗い発光しか得られずまた、温度上昇も甚だしい問題点を生じていた。

【解決手段】 本発明により、ホーン部3が、樹脂基板2を貫通して設けられた上拡がりのテーパ状の貫通孔2aにより構成される反射面3aと、樹脂基板2の底面側から貼着される銅箔4により構成される底面3bとされている平面実装型LED素子1としたことで、上拡がりのテーパ状となるホーン部3の反射面3aによりLEDチップ6からの側方に向かう光を照射方向Zに変換し、光束利用率を向上させ課題を解決する。また、銅箔4により底面3bを構成したことで冷却効率も向上させ、温度上昇の問題も解決する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂基板に反射面と底面とから成るホーン部を設け、該ホーン部の底面にLEDチップをマウントしてなる平面実装型LED素子において、前記ホーン部が、前記樹脂基板を貫通して設けられた上拡がりのテーパ状の貫通孔により構成される反射面と、前記樹脂基板の底面側から貼着される銅箔により構成される底面とされていることを特徴とする平面実装型LED素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、LED素子に関するものであり、フラットパッケージなどと称されて、回路基板の表面に直接に実装可能なパッケージに収納されたLED素子に係るものである。

【0002】

【従来の技術】従来のこの種の平面実装型LED素子90の構成の例を示すものが図2であり、先ず、樹脂基板91はガラス基材エポキシ板などの部材による上部基板92と、同じ部材による下部基板93とから構成され、前記上部基板92には略中心にドリルなど適宜な手段で貫通孔92aが設けられている。

【0003】そして、上部基板92に前記貫通孔92aを背面側から塞ぐように下部基板93が貼着されてホーン部94が構成されるものであり、このときに、前記貫通孔92aの側面がホーン部94の反射面94aと成り、下部基板93の表面がホーン部94の底面94bとなる。

【0004】このように構成された樹脂基板91には前記ホーン部94を含み樹脂メッキなどによる導電部95が適宜な形状として施され、前記ホーン部94の底面94bにはLEDチップ96がマウントされ、金ワイヤ97により配線が行われた後に前記LEDチップ96を覆い透明樹脂によるケース部98が形成されて平面実装型LED素子90とされるものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記した従来の平面実装型LED素子90において、第一には、LEDチップ96をホーン部94の中にマウントしたことで、樹脂基板91と直交する照射方向Zに光を発するものとは成っているが、前記ホーン部94の反射面94aが照射方向Zに対し平行であるので、この反射面94aに達した光を上記した照射方向Zに効率良く変換することができず、LEDチップ96に対する光束利用率が低いという問題点を生じている。

【0006】また第二には、LEDチップ96が全面を樹脂基板91、ケース部98と熱伝導性が低い部材で囲まれているので、通電時のLEDチップ96からの発熱が効率良く外部への放熱が行われず、LEDチップ96が高熱になり易く、従って、通電電流（点灯電流）に制約を受けるものとなって、明るい平面実装型LED素

子90が実現できない問題点も生じ、これらの点の解決が課題とされるものとなっている。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は前記した従来の課題を解決するための具体的な手段として、樹脂基板に反射面と底面とから成るホーン部を設け、該ホーン部の底面にLEDチップをマウントしてなる平面実装型LED素子において、前記ホーン部が、前記樹脂基板を貫通して設けられた上拡がりのテーパ状の貫通孔により構成される反射面と、前記樹脂基板の底面側から貼着される銅箔により構成される底面とされていることを特徴とする平面実装型LED素子を提供することで前記課題を解決するものである。

【0008】

【発明の実施の形態】つぎに、本発明を図に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。図1に符号1で示すものは本発明に係る平面実装型LED素子であり、この平面実装型LED素子1は樹脂基板2にホーン部3が設けられ、このホーン部3にLEDチップ6がマウントされて成るものである点は従来例のものと同様である。

【0009】また、前記ホーン部3は反射面3aと、底面3bとから構成されるものである点も従来例と同様であるが、本発明では前記樹脂基板2を貫通して設ける貫通孔2aを上拡がりのテーパ状とするものであり、これは、適宜な先端角（例えば90°）を有するツイストドリルを適宜な送り込み深さとして穴明け加工を行うことなどで実現可能である。

【0010】また、底面3bは従来例のものが下部基板を貼着していたのに対し、本発明では例えば厚みが0.1mm近傍の銅箔4を樹脂基板2の背面側から前記孔2aを塞ぐようにして貼着するものとしている。従って、本発明においてはホーン部3の反射面3aは貫通孔2aの側面で構成され、ホーン部3の底面3bは銅箔4で構成されるものとなる。

【0011】このときに、前記銅箔4は完成した後の平面実装型LED素子1を回路基板（図示は省略する）に取付けるための端子部4a、4bも兼ねるものとなるので、銅箔4を樹脂基板2の背面側の全面にわたり貼着しておき、後の適宜の時点でエッチングなど適宜な手段により不要部分を削除するなどは自在である。

【0012】上記のように銅箔4が貼着された後の樹脂基板2には、例えば樹脂メッキなどにより適宜な形状とされた導電部5が形成されるが、このときには、導電部5は従来例と同様にホーン部3の反射面3aおよび底面3bを含み行われるものとされている。

【0013】そして、前記ホーン部3の底面3bにはLEDチップ6が一方の極でマウントされ、このLEDチップ6の他方の極には前記導電部5と金ワイヤ7による配線が行われた後に、前記LEDチップ6を覆い透明樹脂によるケース部8が形成されて、本発明の平面実装

型LED素子1とされるのである。

【0014】次いで、上記の構成とした本発明の平面実装型LED素子1の作用および効果について説明する。先ず第一には、樹脂基板2に設けられる貫通孔2aが上拡がりのテーパ状とされたことで、この貫通孔2aの側面で構成されるホーン部3の反射面3aで反射するLEDチップ6からの光は、進行方向をこの平面実装型LED素子1の照射方向Zに向かうものと変換される。

【0015】従って、同じ点灯電流で駆動されている同じ明るさのLEDチップ6に対しても、従来例のこの種の平面実装型LED素子に比較して光束利用率が格段に向上するものとなり、同じ消費電力でより明るい平面実装型LED素子1が得られるものとなる。

【0016】また第二には、ホーン部3の底面3bが、樹脂基板2の背面側に貼着された銅箔4とされたことで、この銅箔4のLEDチップ6がマウントされたのと反対側の面は直接に外部に露出し、機器などへの組込みを行う際には回路基板あるいは外気などに直接に接触するものとなる。

【0017】このことは、前記LEDチップ6に対する冷却効率が向上するものとなるので、同じ定格のLEDチップ6に対しても、より多い点灯電流の供給が可能となり、従来例の平面実装型LED素子に比較して、一層に光量面で高出力を発生することのできる平面実装型LED素子1の実現を可能とする。また、同じ点灯電流であれば、冷却効率が優れる分だけLEDチップ6は低温に保たれるものとなり、寿命面の延長など信頼性にも向上が期待できるものとなる。

【0018】以上を総括すれば、本発明の平面実装型LED素子1においては、テーパ状の貫通孔2a（反射面3a）としたことで、同じ点灯電流でより明るいものとなり、従来通りの明るさで使用する場合であればより少ない点灯電流で良く、即ち、消費電力が低減できるものとなる。

【0019】また、上記反射面3aの構成で明るさが格段に増したことに加えて、底面3bを銅箔4で構成されるものとしたことで、点灯電流の一層の増加が可能となり、双方が相乗して得られる最大の明るさは格段のものとなる。従って、例えば屋外用の表示器など従来の平面実装型LED素子においては不可能な用途にも対応が可

能となり用途の拡大が図れるものとなる。

【0020】

【発明の効果】以上に説明したように本発明により、ホーン部が、樹脂基板を貫通して設けられた上拡がりのテーパ状の貫通孔により構成される反射面と、前記樹脂基板の底面側から貼着される銅箔により構成される底面とされている平面実装型LED素子としたことで、第一には、上拡がりのテーパ状としたホーン部の反射面によりLEDチップからの側方に向かう光を照射方向Zに変換し、光束利用率を向上させ、この種の平面実装型LED素子における効率の向上に極めて優れた効果を奏するものである。

【0021】また第二には、ホーン部の底面が、樹脂基板の背面側に貼着された銅箔とされたことで、この銅箔の一面は直接に外部に露出するものとし、LEDチップに対する冷却効率が向上させ、同じ点灯電流である場合にはLEDチップの温度を低く保ち信頼性の向上が図れるものとすると共に、LEDチップに同じ最大温度を許容する場合には一層に多くの点灯電流の印加を可能とし、更に一層に明るい平面実装型LED素子の実現を可能とし、この種の平面実装型LED素子の用途の拡大などにも優れた効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

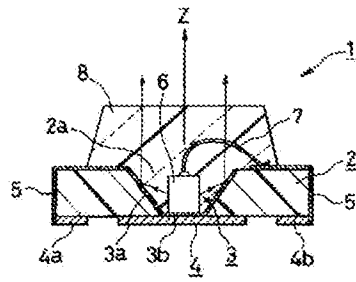
【図1】 本発明に係る平面実装型LED素子の実施形態を示す断面図である。

【図2】 従来例を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1……平面実装型LED素子
- 2……樹脂基板
- 2a……貫通孔
- 3……ホーン部
- 3a……反射面
- 3b……底面
- 4……銅箔
- 4a、4b……端子部
- 5……導電部
- 6……LEDチップ
- 7……金ワイヤ
- 8……ケース部
- Z……照射方向

【図1】



【図2】

